

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年8月31日(31.08.2023)



(10) 国際公開番号

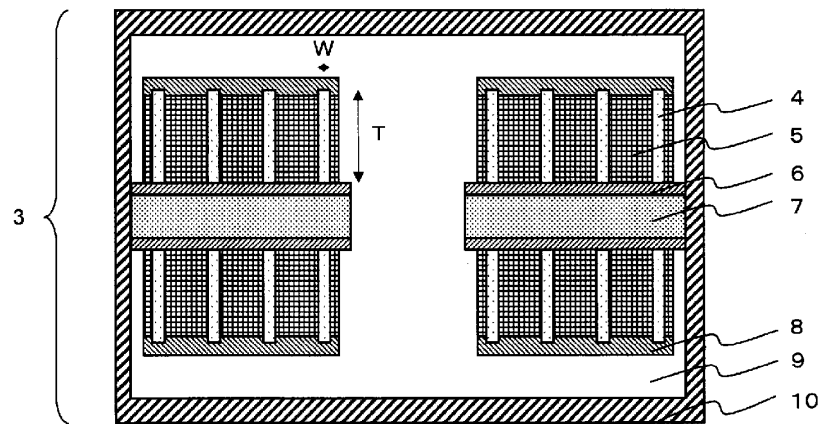
WO 2023/162718 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 59/40 (2006.01) G03F 7/004 (2006.01)
C08G 65/18 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/004533
- (22) 国際出願日: 2023年2月10日(10.02.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-026410 2022年2月24日(24.02.2022) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 加藤圭悟 (KATO, Keigo); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 松村和行 (MATSUMURA, Kazuyuki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 楯岡佳子 (TATEOKA, Yoshiko); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 嶋田彰 (SHIMADA, Akira); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,

(54) Title: RESIN COMPOSITION, RESIN COMPOSITION COATING FILM, RESIN COMPOSITION FILM, CURED FILM, AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING THESE PRODUCTS

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、樹脂組成物被膜、樹脂組成物フィルム、硬化膜、およびこれらを用いた半導体装置

【図2】



(57) Abstract: Provided is a resin composition comprising a component (A) comprising at least one polymeric compound selected from the group consisting of polyamide, polyimide, polyamideimide and polybenzoxazole, a component (B) comprising a cationically polymerizable compound, and a component (C) comprising a photo-cationic polymerization initiator, in which the component (B) comprises both of a component (B1) comprising an epoxy compound and a component (B2) comprising an oxetane compound. A resin composition is provided, which has satisfactory mechanical properties and thermal properties and is capable of forming a pattern having a large thickness and a high aspect ratio.

[続葉有]

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: (A) 成分としてポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、およびポリベンゾオキサゾールからなる群より選ばれる少なくとも1つの高分子化合物、(B) 成分としてカチオン重合性化合物、(C) 成分として光カチオン重合開始剤を含有する樹脂組成物であって、前記(B)成分が、(B1)成分としてエポキシ化合物と(B2)成分としてオキセタン化合物の両方を含有する、樹脂組成物。十分な機械特性と熱特性を有し、厚膜で高アスペクト比なパターン形成が可能な樹脂組成物を提供する。